

鉛フリーソルダペースト SN96CI PF-33 FMQ (Sn-Ag-Cu)

リフローピーク230～235

リフローはんだ付に適した、Sn-Ag-Cu系共晶鉛フリーはんだです。

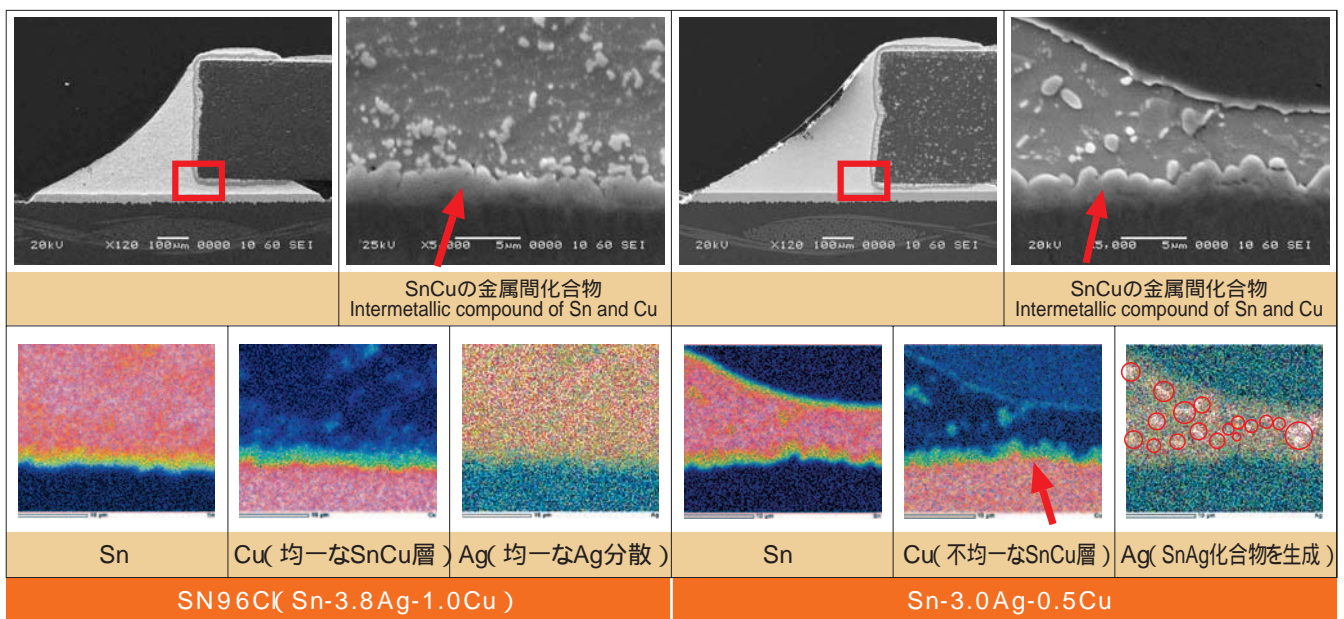
特長

- 安定したSnCu合金層が形成されます。
- Agを均一に分散し、SnAg化合物の生成を抑制します。
- 光沢のあるフィレットが形成されます。
- 引け巣(引け割れ)の発生がほとんどありません。
- 連続印刷時、安定した粘度を保持します。



安定した合金層の形成

高い接合部信頼性があります。



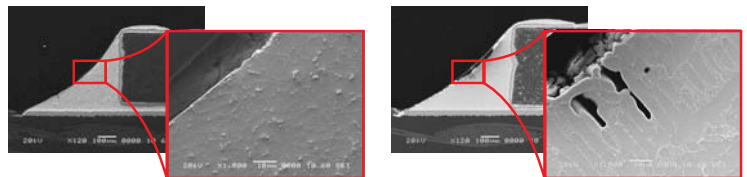
光沢のあるフィレット形成



SN96CI(Sn-3.8Ag-1.0Cu)

Sn-3.0Ag-0.5Cu

引け巣の発生を低減

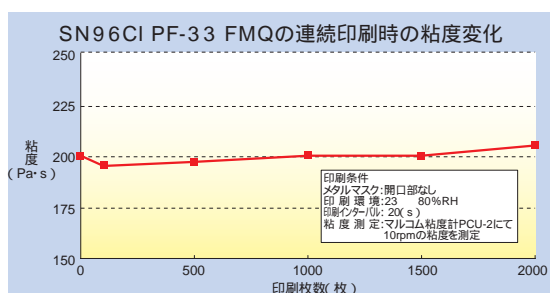


SN96CI(Sn-3.8Ag-1.0Cu)

Sn-3.0Ag-0.5Cu

粘度安定性

連続印刷(2000枚)に対して良好な印刷性を保持します。



推奨温度プロファイル

